



2023年12月21日

各位

会社名 AIメカテック株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 阿部 猪佐雄
(コード番号: 6227 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営企画部長 米田達也
(TEL 0297-62-9111)

大手半導体関連メーカーより大口受注のお知らせ

当社は、海外の大手半導体関連メーカーより、ウェハハンドリングシステムを大口受注いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 今回の受注について

半導体製造プロセスにおいては、AI、5G、IoT、及び自動運転市場などの成長を背景に、三次元実装（2.5Dおよび3D）およびファンアウト半導体パッケージに対する需要拡大から、更なる薄化・積層化が求められています。当該システムは、その薄化・積層化に対し重要なプロセスの一つを担っています。

当社では、長年培ってきたウェハの仮接合技術及び薄化後のウェハからサポートガラスを剥がし洗浄するプロセス技術にモノづくり力を融合した、高性能なウェハハンドリングシステムを提案して参りました。その結果、安定した品質と歩留まり向上を実現できる点が評価され、今般の受注に至りました。

2. 受注内容

受注製品 ウェハハンドリングシステム（ボンダー・デボンダー装置）
受注金額 約28億円
売上計上予定 2025年6月期

3. 業績への影響

当該受注の売上計上は2025年6月期を予定しており、2024年6月期通期連結業績予想に与える影響はありません。なお、当該受注はすべて円建てとなっており、為替レートの変動による影響はありません。

以上